

# 东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

## (2026 年 8 月 31 日)

证券代码：688110

证券简称：东芯股份

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系<br>活动类别     | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他（策略会）                                                                                                        |
| 参与单位名称            | 汇添富基金、长城基金、上银基金、未来资产、新华资产、国泰基金、华泰资产、平安资产、景顺长城基金、前海开源基金、国华兴益保险、招商基金、百年资管、华商基金、中泰资管、朱雀基金、海创基金、浙商资管、泉果基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 活动时间              | 2026 年 8 月 24 日、8 月 25 日、8 月 26 日、8 月 27 日、8 月 28 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 活动地点              | 反路演                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 上市公司接待人员姓名        | 董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟<br>证券事务代表：黄沈幪<br>投资者关系：唐超宇、杨丽颖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 投资者关系<br>活动主要内容介绍 | <p><b>1、当前来看存储产品的价格趋势如何？怎么看未来的利基存储行业趋势？</b></p> <p>答：当前来看，由于供给侧紧缺尚未完全缓解，公司利基型存储产品价格仍处于结构性上涨通道中。不过，因各细分产品的紧缺程度存在差异，且下游客户对产品质量、稳定性等要求不尽相同，不同产品的涨价幅度和节奏也有所分化。供需与价格相互影响，公司在定价过程中会综合考量盈利能力、产品竞争力以及与客户合作的长期稳定性等多方面因素。本轮 AI 需求爆发带来的供需变化，对公司而言是重要的发展窗口期。公司将紧抓市场机遇，依托自身产品品质和经营能力，进一步巩固和扩大市场份额，持续增强核心竞争优势。关于未来行业趋势，公司将保持持续跟踪与研判。</p> <p><b>2、存货水平如何？</b></p> <p>答：公司采用 Fabless 模式运营，与国内外多家知名晶圆代工厂和封测厂建立了互助、互利、互信的合作关系，构建了“本土深度、全球广度”</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>的供应链体系，目前公司产能供应稳定。截至 2026 年 6 月 30 日，公司存货金额为 12.82 亿元，公司存货主要由原材料、委托加工物资、库存商品等构成，其中以晶圆等原材料占比较大，因其为通用型产品，风险相对可控。公司目前存货结构整体健康，并将持续关注市场动态，灵活调整库存策略与产能规划，积极把握市场机遇。</p> <p><b>3、公司的 LPDDR4 下游客户会不会转向 LPDDR5？</b></p> <p>答：从性能、成本角度看，公司服务的工控、车规、IoT 等利基客户，较少主动将存量平台由 LPDDR4 切换 LPDDR5，原因主要有以下几点：在性能上，这类场景带宽需求有限，LPDDR4 性能已经满足使用，LPDDR5 的高带宽优势难以充分发挥，同时高频特性也提高了硬件调试难度；在价格上，同等容量下 LPDDR5 器件成本更高，工业、车规版本溢价更为明显，会抬升终端 BOM 成本；同时切换芯片涉及主控、硬件、驱动改版，若应用于车规还需重新完成全套认证，研发与时间成本很高，存量成熟平台改动动力不足。公司将持续关注下游客户需求变化及 DRAM 技术演进趋势，结合市场需求做好相关产品规划。</p> <p><b>4、存算联融合芯片项目会使用砺算的计算芯片相关技术吗？</b></p> <p>答：存算联融合芯片项目的计算芯片由公司自有技术团队自主研发。项目技术方案主要依托公司自身在存储和联接领域的积累，算力部分则根据项目对低功耗、高能效及本地智能处理的要求进行针对性设计，并非直接复用砺算科技的 GPU 技术。该项目旨在通过先进封装技术将存储芯片、联接芯片与计算芯片集成于单芯片，打造低功耗嵌入式智能计算芯片，具备本地智能处理、数据隐私安全、低延迟、低功耗等特点。项目团队在 RISC-V 架构、AI 加速、ISP 图像处理及超低功耗显示等技术方向积累了较为完整的研发能力，覆盖芯片架构定义、设计验证、封装测试及量产的全流程，并可提供软硬一体化解决方案。存储与联接部分将充分复用公司内部已有技术积累，算力部分则结合项目实际需求进行定制化开发，以保障产品在性能、功耗和集成度上的综合表现。该项目相关议案尚需提交公司股东会审议，敬请注意投资风险。</p> <p><b>5、存算联融合芯片的潜在客户预计有哪些？</b></p> <p>答：该产品定位对成本、功耗、体积敏感的端侧智能场景，潜在客户主要覆盖智能家居、工业物联网、能源管理、消费电子、医疗健康领域。公司也将依托现有工控领域的客户基础，积极挖掘存量客户中与之契合的应用需求。目前项目尚处于推进阶段，上述领域系基于产品定位的应用方向判断，具体客户导入情况请以公司后续披露信息为准。</p> |
| 日期 | 2026年8月31日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |